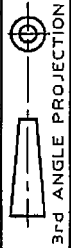


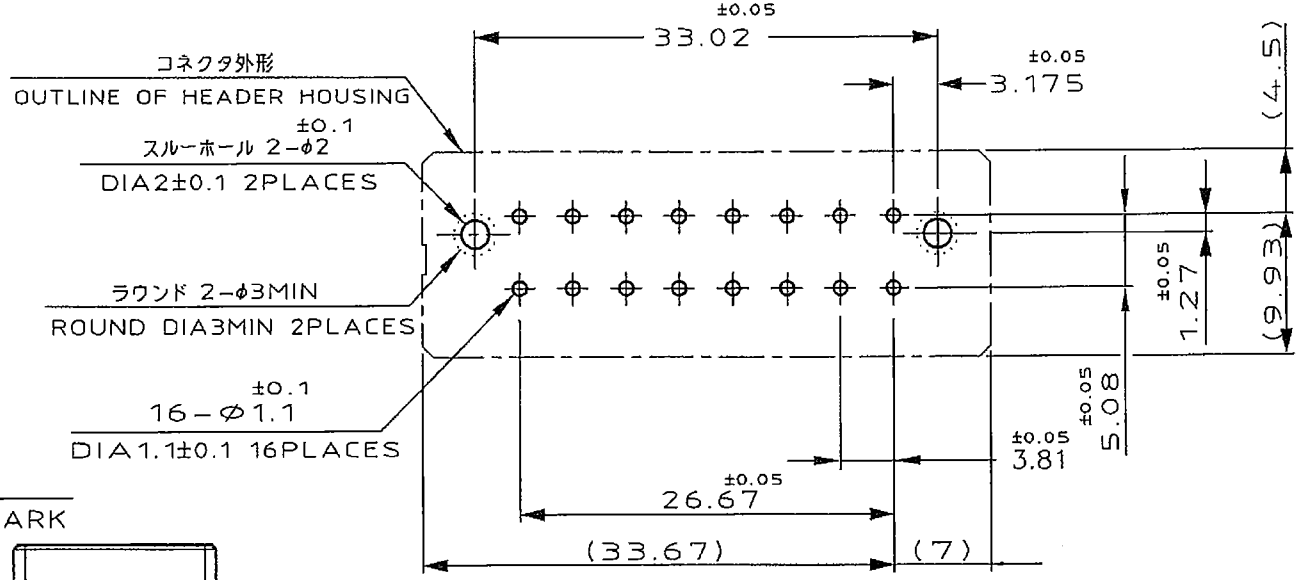
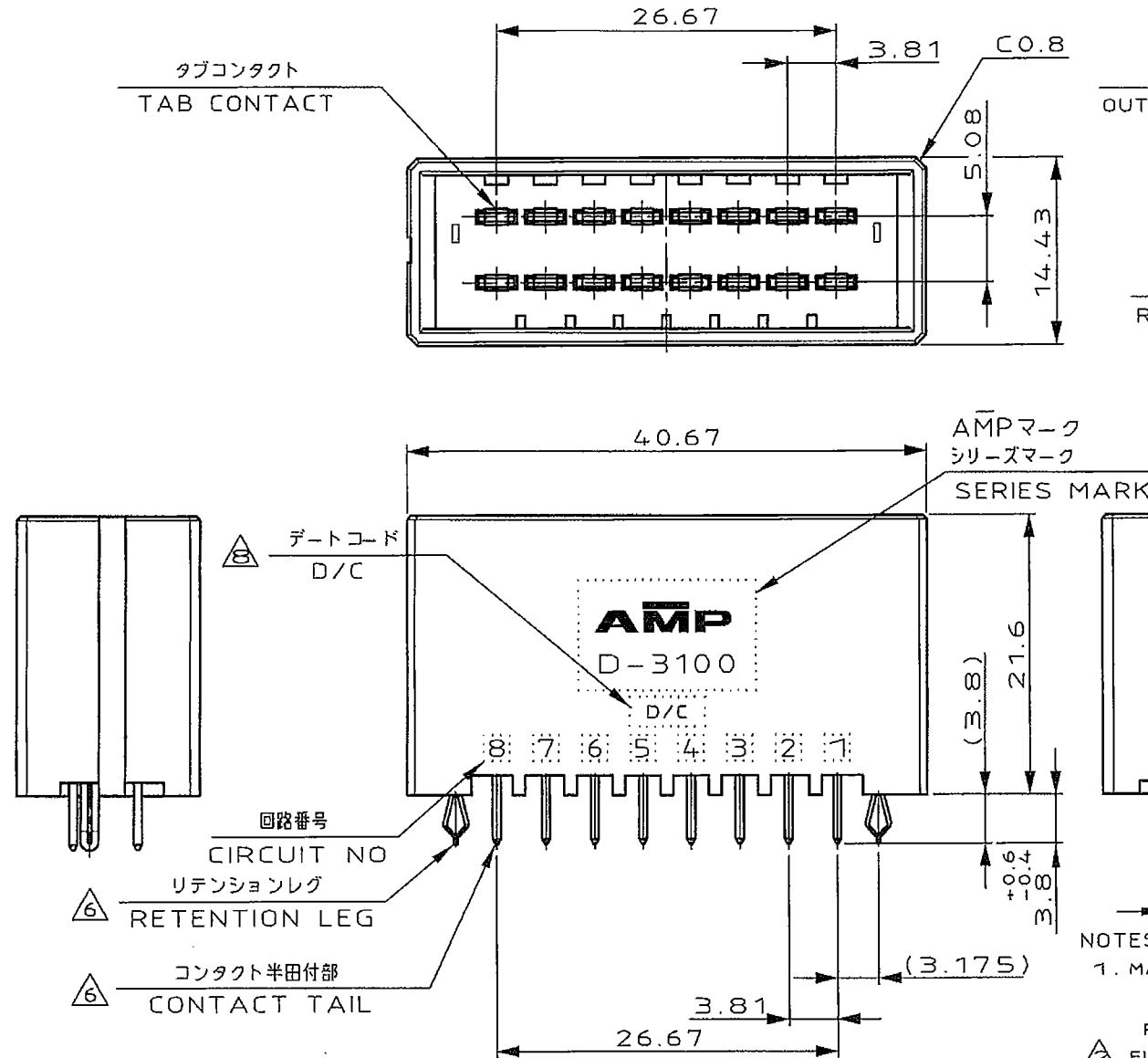
NUMBER 178327



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6±0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- THE SHAPE, SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE THEY DON'T SHOW DETAILS
- THE DATE CODE SHOW PRODUCTION LOT BY NUMBER. THE NUMBER MAKE UP THE NUMBER OF FOUR COLUMNS OR FIVE COLUMNS. (INCLUDE THE ALPHABET)

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
コネクタ: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
接触部: 0.38μm MIN 金めっき
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
接触部: 0.76μm MIN 金めっき
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部  
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部  
ニッケル下地の土にスズめっき
- 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません
- 4桁の数字及びアルファベットを含む5桁の数字により製造ロットを示す。

△	△	178327-6
△	△	178327-5
△	△	178327-3
△	△	178327-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

E3	REVISED	N.W.K.Z.X.X	DR. 19 APR 94	DE. 19 APR 94
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
			CHK. N. MATSUBARA	APP. N. MATSUBARA
			CHK. S. MANABE	APP. S. MANABE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm²(AWG - )		mm²		16 POS DOUBLE ROW	
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE		VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
注記参照		注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
				10% ±0.3	A3 J
				30% ±0.4	C-178327
				50% ±0.45	SCALE REV. SHEET
				±3'	2-1 E3 1 OF 1



(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)